

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

公告编号：2026-034

# **东芯半导体股份有限公司**

## **关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司**

### **上市相关事项的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等议案，现将有关情况公告如下：

为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，深化公司全球化战略布局，面向国际资本市场拓宽融资渠道，构建多元化资本运作平台，公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《监管规则适用指引——境外发行上市类第1号》等相关法律、法规的要求，公司本次发行上市符合中国境内法律、法规和规范性文件的要求和条件。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）以及香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定，公司本次发行上市事宜将在符合香港法律及《香港联交所上市规则》的要求和条件下进行，并需要根据取得中国证券监督管理委员会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。

截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未确

定。本次发行上市能否通过审议、批准、核准和备案程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

**东芯半导体股份有限公司董事会**

**2026年5月23日**